



横浜・中途採用・技術職求人・先端半導体パッケージ材料エンジニア・関連経験者歓迎・中国語堪能な方歓迎！

技術職 大手企業で働く 雰囲気友好 高年収 社保完備 交通費支給 中国語活用

Job Information

Hiring Company

iSoftStone

Subsidiary

株式会社iSoftStone Japan

Job ID

1618804

Division

技術

Industry

Communication

Company Type

Large Company (more than 300 employees) - International Company

Non-Japanese Ratio

About half Japanese

Job Type

Contract

Location

Kanagawa Prefecture, Yokohama-shi Kanagawa-ku

Salary

6 million yen ~ 10 million yen

Work Hours

平日9:00-18:00 (休憩時間 60分)

Holidays

年間休日 120日以上 有給休暇 初年度 10日(6か月目~) 完全週休二日制 土 日 祝日 年末年始

Refreshed

October 21st, 2026 17:29

General Requirements

Minimum Experience Level

Over 1 year

Career Level

Mid Career

Minimum English Level

Business Level

Minimum Japanese Level

Business Level

Other Language

Chinese (Mandarin) - Business Level

Minimum Education Level

Bachelor's Degree

Visa Status

Permission to work in Japan required

Job Description

【仕事内容】：

1. 半導体パッケージ材料メーカーとのやり取り、評価計画の立案
 2. 半導体パッケージ向け材料を用いて特性評価用サンプルの製作、特性評価
 3. 課題と問題解決に向けて改善案の提案
-

Required Skills

【必須条件】：

半導体パッケージ材料メーカーでの勤務経験≧2年
特性評価設備の経験≧2年

【歓迎条件】：

・積極性、責任感、コミュニケーション能力、勉強意欲
・ケミカル分野のエンジニアです。日本の研究機関での業務経験有りますが、戦力になって頂く為に日本の材料メーカーで勤務経験有る方、可能であれば中国出身の方を探したいと思います。

【語学力】：

日本語：ビジネスレベル以上
中国語：ビジネスレベル以上

Company Description